

# 中期経営計画 FV26

(期間：2024年-2026年)

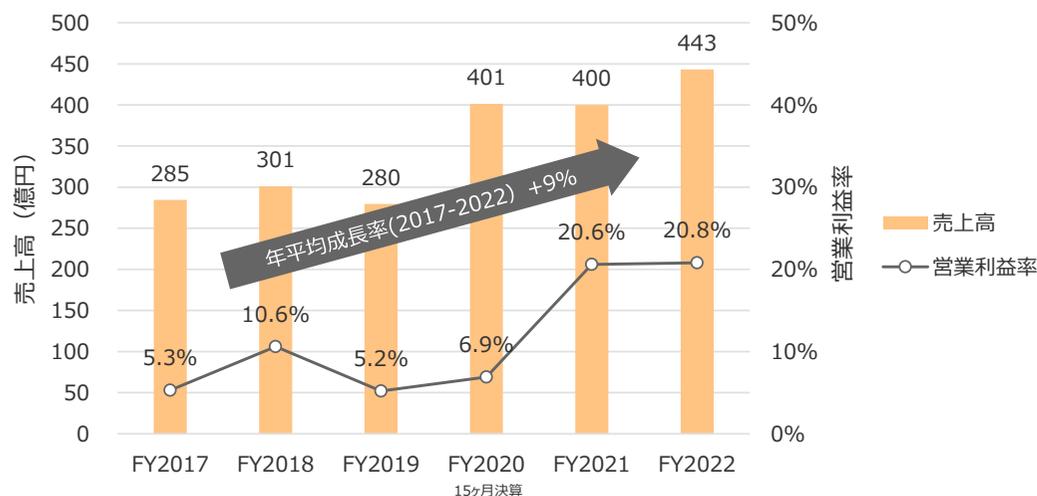
# 目次

1. MJC Future Visionの振り返り
2. プローブカード市場の将来展望
3. 経営指標
4. プローブカード事業
5. TE事業
6. 成長への取り組み
7. 社会課題と生産性向上への取り組み
8. まとめ

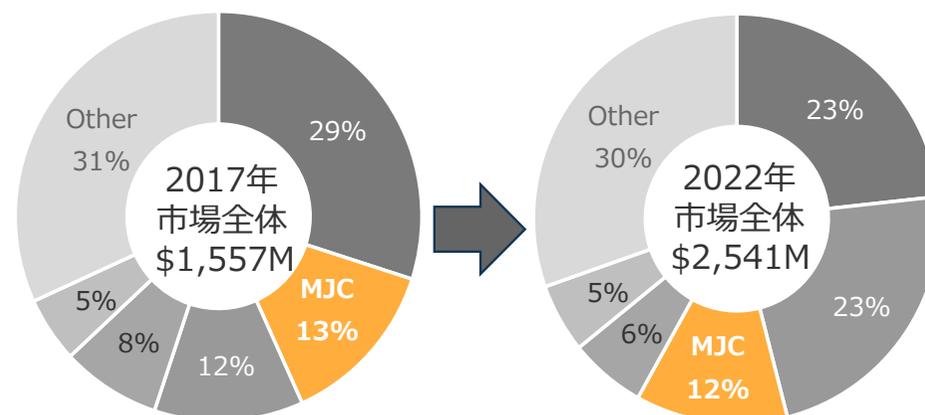
# MJC Future Visionの振り返り

- 2022年度のプローブカード市場シェアは12%と市場成長と共に売上高・営業利益は過去最高を達成
- DRAM向けプローブカード事業は、圧倒的なNo.1シェアを確保し、No2に対して約倍の差をつける成果
- NAND向けは、市場が拡大するなか売上高増加、しかし顧客の投資バランス調整などの影響によりシェア低下
- ノンメモリ（ロジック）向けプローブカードは、目標としていた売上高構成比率4割に届かず。しかし、国内カンチレバープローブカードの生産中止など、アドバンスプローブカードへの集中体制を構築
- TE事業は半導体検査分野へリソース集中し、新製品開発に注力

## 売上高・営業利益率の推移



## PC市場売上高とシェアの推移



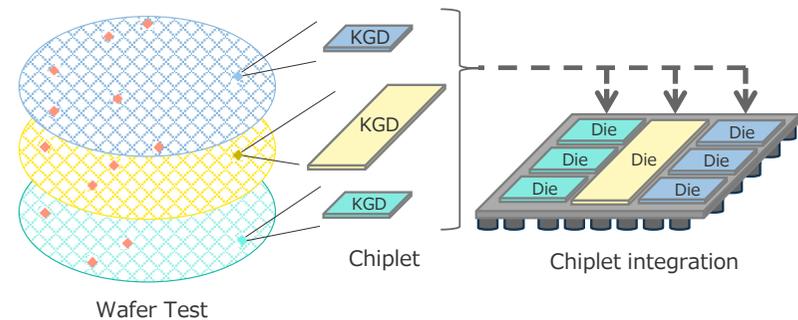
(TechInsights社データをもとに当社が作成)

# プローブカード市場の将来展望

- 2024年以降はプローブカード市場は、半導体製造装置市場よりも高い成長率で推移
- 半導体デバイスの用途拡大、高機能化に伴うテストの長時間化によりプローブカードの需要は増加
- Chipletを集積した半導体デバイス増加に伴う、ウェーハテストの新たなニーズが出現
- 半導体デバイスの高集積化・高速化・低消費電力化により高性能なプローブカードの開発ニーズは継続



・生成AIの発展とそれに伴うデータセンタ需要の拡大



・Chipletを集積した半導体デバイスの増加

KGD: Known Good Die (不良品でないことが保証されたペアチップの通称)

グラフはGartnerリサーチを基に当社にて数値を算出し作成。

出所, Gartner®, Forecast: Semiconductor Capital Spending, Wafer Fab Equipment and Capacity, Worldwide, 2Q23 Update, Bob Johnson et al., 4 July 2023  
半導体製造装置市場, 半導体製造装置 = Total Wafer Fab Equipment  
GARTNERは, Gartner Inc.または関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり, 同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved.

出所  
プローブカード市場: 当社独自予測

## 経営指標

- 最終年度FY2026売上高650億円は、売上高年平均成長率（'24-'26）20%以上
- 積極的な投資計画で、営業利益率23%、ROE20%

| 経営指標（最終年度FY2026） |       |
|------------------|-------|
| 売上高              | 650億円 |
| 営業利益額            | 150億円 |
| 営業利益率            | 23%   |
| ROE              | 20%   |

- 前提条件：プロブカード市場が年平均成長率('24-'26)7%で成長した場合
- 前提としてUSD：130円/ドル

| 投資計画（FY2023～FY2026） |       |
|---------------------|-------|
| 設備投資額               | 300億円 |
| 研究開発費               | 200億円 |
| 総額                  | 500億円 |

# プローブカード事業

- メモリ向けプローブカードは生産能力強化と新技術開発で圧倒的なシェアNo.1を維持
- ノンメモリ向けプローブカードはMEMSタイプの新製品投入によりシェア拡大を目指す
- お客様へのサポートを充実させ、より一層サービスを充実させるとともに、  
新たなお客様とのリレーションを築いていく

MEMSタイプの新製品投入により成長  
ノンメモリ向け製品

MEMS-SP

新製品

MEMS-V

圧倒的なNo.1ポジションへ  
メモリ向け製品

SP-Probe  
(Flash)

PCB less  
U-Probe  
(Flash)

PCB less  
U-Probe  
(DRAM)

U-Probe  
(Flash)

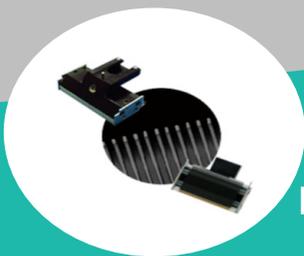
U-Probe  
(DRAM)

# TE事業

- コンタクトビジネスの成長による安定収益源
- 半導体テスト向けの新製品で、新たな価値を創造し成長
- お客様へのサービスをより充実させることで、フィールドサポート（ポストセールス）を第三の収入源

## 新製品で価値創造 成長戦略

コンタクトビジネス  
安定収益



Probe Unit



Prober  
Accessories



Model 708ft  
※既存製品

Prober

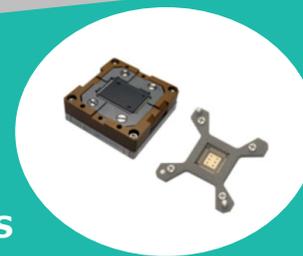


Custom Tester

Tester



Field Support  
(FS)



Package Probe  
(Test Socket)

# 成長への取り組み（設備投資）

## 青森工場の新棟建設開始

- プロブカードの需要増加に対する設備増強
- 建物面積約9,200㎡
- 2025年Q1より順次稼働開始予定



【青森工場新棟イメージ】

## 韓国MEK Co.,Ltd.新工場建設

- 半導体需要拡大に対する生産スペースの拡張
- 建物面積2,349㎡
- 2023年9月稼働開始予定



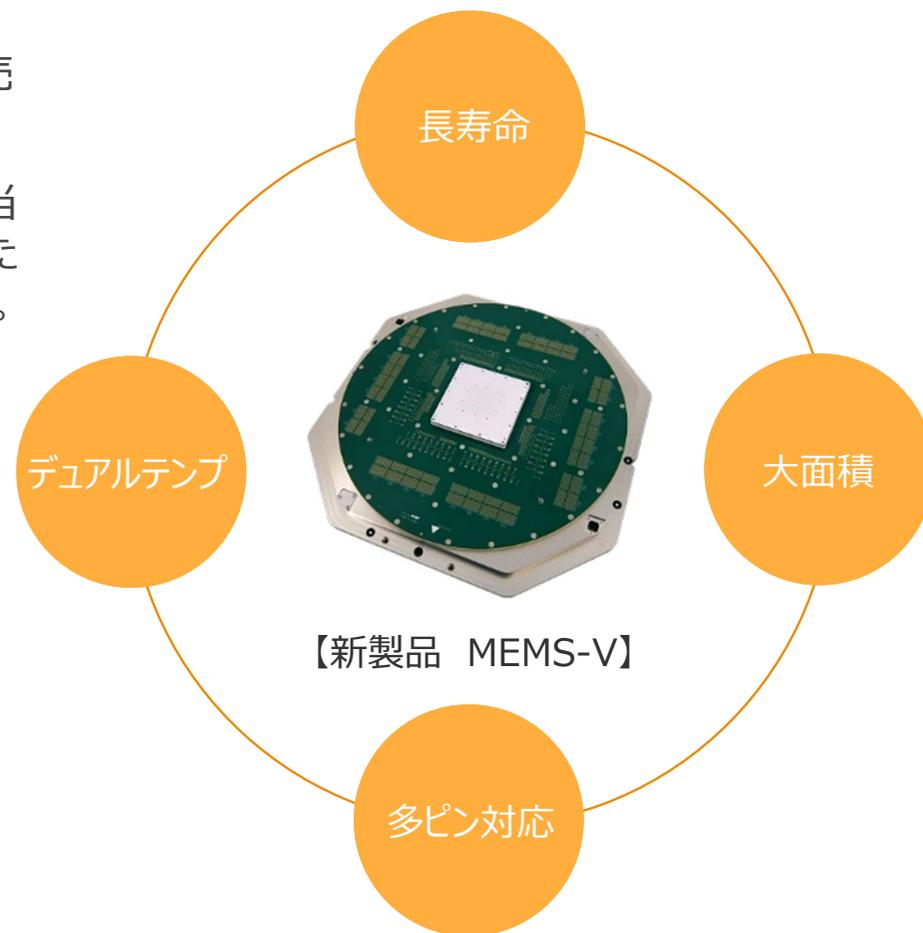
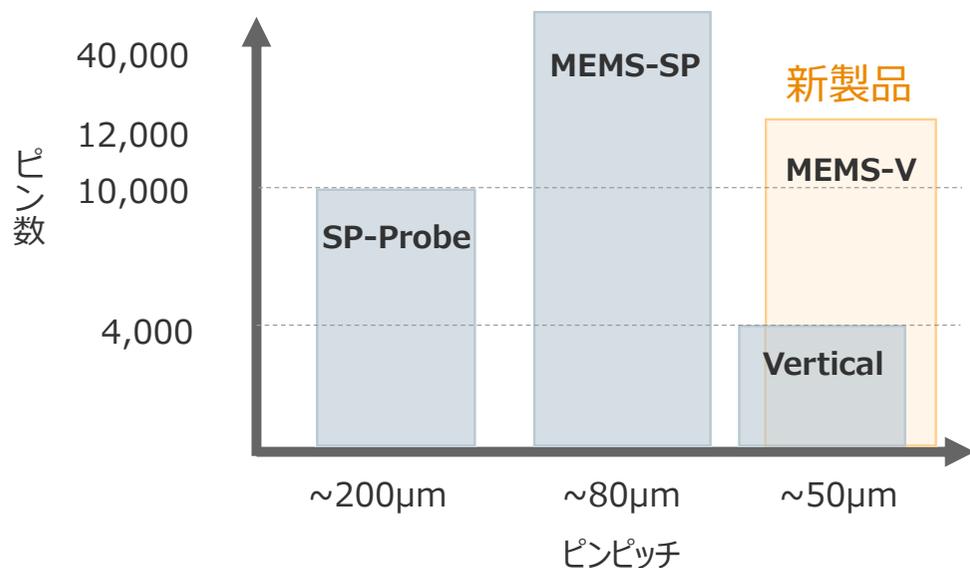
【MEK新工場】

# 成長への取り組み（研究開発）

## 新製品リリース「MEMS-V」

ロジック半導体向け垂直型MEMSプローブカード「MEMS-V」の販売を開始致します。

メモリ向けで実績のあるMEMS製造技術を用いた新型プローブと当社独自の基板技術によるデュアルテンプ対応など、車載を中心としたロジックデバイス向けとして、テストの品質向上に貢献します。当社中期計画におけるノンメモリプローブカード事業の新たな中核製品のひとつとなります。



# 社会課題と生産性向上への取り組み

## サステナビリティへの対応

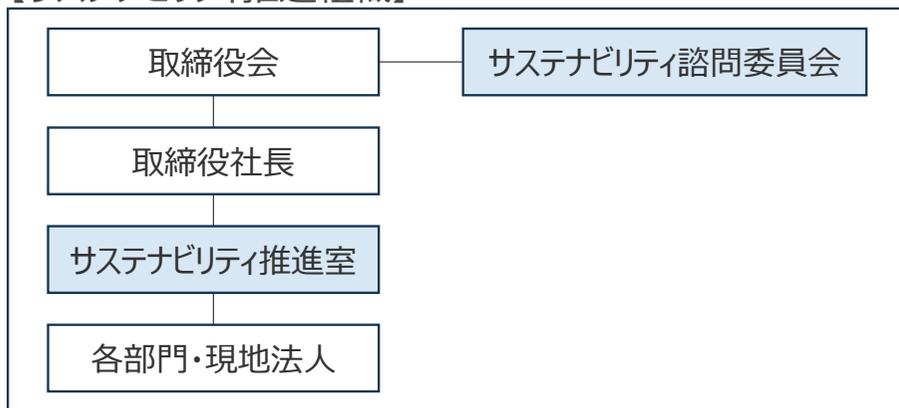
2023年3月30日付でサステナビリティに関する新部門設置

1. サステナビリティ推進室
2. サステナビリティ諮問委員会（取締役会の諮問機関）

執行役であるサステナビリティ推進室と管理・監督役であるサステナビリティ諮問委員会でサステナビリティ対応を推進

- 気候変動におけるTCFD\*、CDP\*\*等への対応
- 人的資本である人財育成、ダイバーシティ、従業員エンゲージメント等への対応など

### 【サステナビリティ推進組織】



TCFD\* 気候関連財務情報開示タスクフォース (Task Force on Climate-related Financial Disclosures)  
CDP\*\* Carbon Discloser Project



© 2024 Micronics Japan Co., Ltd.

## デジタルトランスフォーメーションへの対応

経営企画戦略本部内のDX情報システム室が推進

社内インフラの整備と、情報セキュリティの強化を図るとともに、ITデジタル技術を用い様々なデータの活用を推進することで、「業務効率化・生産性向上」に取り組んでおります。

### 【DX推進の取組み例】

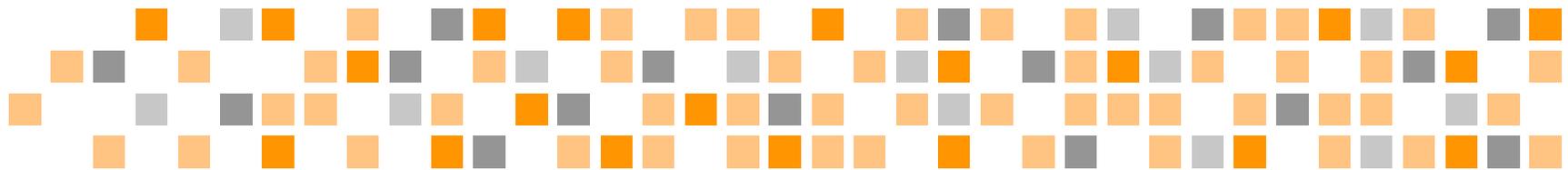
社内ポータルサイトで「業務効率化・生産性向上」の取組みを紹介。優秀な取組みを表彰





## まとめ

- 新中期経営計画FV26は、MJC Future Visionを踏まえ、2026年を最終年度とし、市場成長を上回る成長を目指します。
- 積極的に設備投資・研究開発へ投資することで、お客さまのニーズに応じて共に成長して参ります。
- サステナビリティへの取り組み、DX推進を成長の機会と捉え、人材育成と組織力を強化し推進します。
- 電子計測技術を通して、企業価値の向上と社会貢献に努めます。



本資料で述べられている技術情報は、製品の標準的動作・応用を説明するための  
ものであり、その使用に際して当社および第三者の知的財産、その他の権利に対する  
保証または実施権の許諾を行なうものではありません。